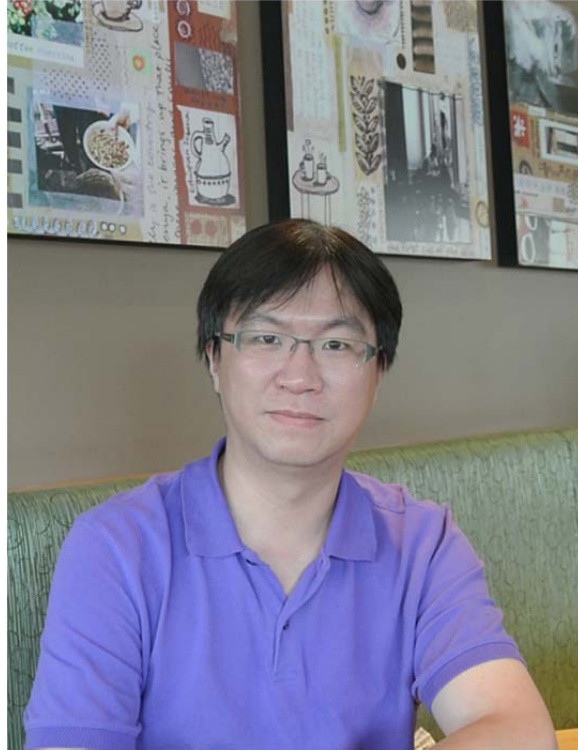
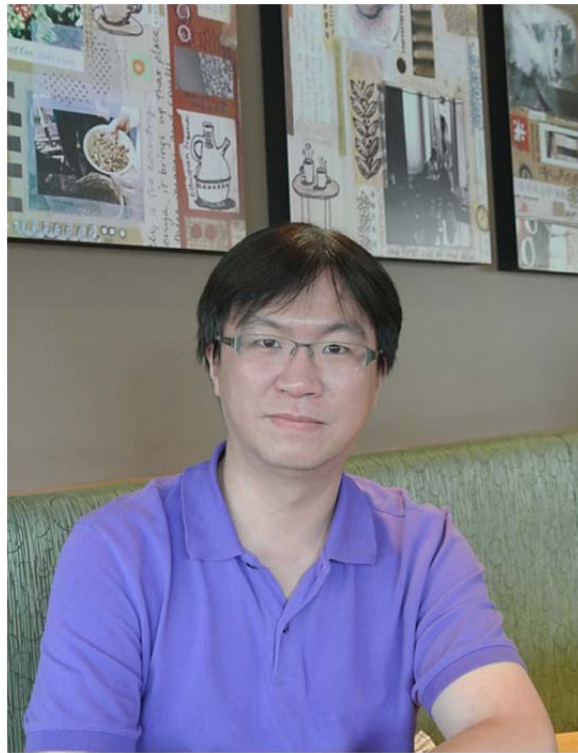


## 國立清華大學第 21 屆新進人員研究獎得獎人簡介



李昌駿博士之主要研究領域，係在最具挑戰性的半導體元件佈局設計與應變矽工程相關的分析、軟性電子/可撓式顯示元件設計、奈米元件結構之力學行為分析與設計、以及多層堆疊薄膜破壞現象與機制等方面，研究成果豐碩。以其專業背景，能夠將半導體積體電路與製程前段、後段技術與系統整合之經驗予以貫徹聯結，其結合學界研究與產業界的經驗殊為難得。迄今已發表 SCI 期刊 102 篇、國內外研討會論文 149 篇，通過台灣專利 10 項以及美國專利 2 項。目前亦已經執行超過 40 件產業界計畫或委託案。由於其在機械固體計算力學方面呈現優秀之學術表現，以及同時執行數個國科會(科技部)多年期具前瞻技術之研究計畫與產學計畫，其研究潛能與成果亦深獲產業界之重視，在 2013 年榮獲行政院國家科學委員會吳大猷先生紀念獎，2014 年中原大學研究傑出獎，連續三年中原大學「中原年輕學者」獎勵(2012-2014)，國際先進製造研討會 (ICAM 2014) 優秀年輕學者獎，中國機械工程學會 105 年度優秀青年工程教授獎，中華民國力學學會 105 年度年輕力學學者獎。此外，李博士亦獲邀擔任 SCI 期刊 Journal of Mechanics 之副編輯與 IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology 之客座編輯，並晉升國際電機電子工程師學會資深會員 (IEEE Senior Member)。



**Chang-Chun Lee**

**Prof. Chang-Chun Lee** has published more than 250 journal/conference papers in the area of computational solid mechanics, mechanical designs/integrations of 3D-IC system, back-end-of-line (BEOL) physical reliability investigation of nano-micro devices, strained silicon engineering, and advanced electronic packaging/ MEMS technologies. He was responsible for more than 45 electronic packaging/MEMS and display technology projects related to flexible organic light-emitting diode (OLED) devices, package simulation/design, and reliability estimation of 3D-ICs. Currently, he serves as a guest editor of IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology and an associate editor of Microelectronic Reliability. His recent research focuses on the robust designs of electronic packaging reliability, SiC/SiGe/GeSn strained techniques in the advanced MOSFETs/FinFETs, phenomenon analysis of stress-migration/electro-migration in IC devices, as well as the interfacial fracture investigation of thin films.